

恒温ディップコーティング装置

商品番号: TB28



前書き

恒温ディップコーティング装置は、プログラム可能な引き上げ速度、温度制御、浸漬および乾燥時間のタイマー機能を備えており、電池研究、材料科学、セラミックス研究室、学術的なコーティング開発ワークフローにおいて、小型試料に対する再現性の高い薄膜作製と一貫したプロセス制御を実現します。

詳細を学ぶ

アプリケーション	説明	主な利点
電池電極材料研究	電池材料および電極開発作業における小型試料への制御されたコーティング試験をサポート。プログラム可能な引き上げ、熱制御、時間ステップにより、明確な実験プロセスを提供します。	引き上げ速度、浸漬時間、乾燥時間、サイクル数の再現可能な制御。
薄膜プロセス開発	指定された試料寸法内の小型平板基板に対するディップコーティング条件のラボ評価を可能にします。構造化されたプロセス研究の一環として、動作や時間設定を変化させることができます。	比較試験のための1 mm/min～200 mm/minの調整可能な引き上げ速度範囲。
セラミックコーティング研究	制御された浸漬長と時間管理されたプロセスシーケンスが必要な小型セラミック試験片の浸漬および乾燥研究をサポートします。	60 mmの有効浸漬長と1～999秒のタイミング設定範囲。
表面処理実験	繰り返しの引き上げサイクルと温度管理された処理条件を使用して、コーティングされた表面を研究するための制御されたプラットフォームを提供します。	多段階コーティング作業のために最大20回の引き上げサイクルを設定可能。
材料科学研究室	その後の特性評価、比較、または材料評価のためにコーティングされた試料を作製する研究チームをサポートします。	指定された試料寸法と引き上げ荷重制限により、明確な動作境界を確立。
学術教育研究室	引き上げ速度、浸漬時間、乾燥時間、サイクル数、温度の関係を実証するための構造化されたラボツールを提供します。	プログラム可能な設定により、プロセス変数が明確になり、文書化が容易。
研究用コーティング手法の最適化	温度、速度、タイミング、引き上げ回数の制御値を使用して、動作レシピを確立・比較するのに役立ちます。	複数の調整可能なパラメータが、組織的な実験計画をサポート。

パラメータ	仕様
製品識別子	TB28
製品タイプ	恒温ディップコーティング装置
定格電圧および電力	220V 850W
電源要件	AC220V 50Hz、確実な接地が必要
引き上げ速度	1 mm/min～200 mm/min
温度	室温～100°C
有効浸漬長	60 mm

パラメータ	仕様
浸漬および乾燥時間設定	1～999秒
引き上げサイクル数	1～20回
引き上げ荷重	100g以下
試料サイズ	75mm x 25mm x 2.5mm
本体寸法	450mm x 500mm x 970mm
温度制御エンクロージャー温度範囲	室温+5～100℃
温度制御エンクロージャー温度変動	±1.5℃
温度制御エンクロージャー外形寸法	460 x 510 x 695
設置高度	1000m以下
設置環境温度	25℃ ±15℃
設置環境湿度	55%Rh ±10%Rh
水供給要件	不要
ガス供給要件	不要
換気要件	不要
必要な作業台サイズ	800mm x 600mm x 700mm
必要な作業台耐荷重	200kg以上